

国金证券股份有限公司
关于上海芯密科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）



（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年六月

声 明

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海芯密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》一致。

目 录

声 明	1
目 录	2
一、发行人基本情况	4
（一）发行人概况.....	4
（二）发行人的主营业务、核心技术、研发水平.....	4
（三）发行人主要经营和财务数据及指标.....	8
（四）发行人存在的主要风险.....	9
二、本次发行概况	10
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式	11
（一）本次证券发行上市的保荐代表人.....	11
（二）本次证券发行项目协办人.....	12
（三）本次证券发行项目组其他成员.....	12
（四）联系地址、电话和其他通讯方式.....	12
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明	13
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项	13
六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明	14
七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程	15
（一）发行人符合科创板支持方向.....	15
（二）发行人符合科创板行业领域的规定.....	17
（三）发行人符合科创属性相关指标要求.....	18
（四）发行人符合国家产业政策.....	18
（五）保荐机构执行核查程序.....	18
八、保荐人关于发行人是否符合《科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明	19
（一）符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条之“（一）符合中国证监会规定的	

发行条件”规定.....	19
（二）发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定.....	21
（三）发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”规定	21
（四）发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条之“（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准”规定.....	21
（五）发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条之“（五）上海证券交易所规定的其他上市条件”规定.....	22
九、持续督导期间的工作安排	22
十、保荐人关于本项目的推荐结论	23

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称（中文）	上海芯密科技股份有限公司
发行人名称（英文）	IC Seal Co., Ltd.
注册资本	5,182.6765 万元
法定代表人	谢昌杰
有限公司成立日期	2020 年 1 月 21 日
股份公司设立日期	2024 年 10 月 28 日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路 2699 弄 13 号厂房一楼南区
邮政编码	201306
电 话	021-20965188
传 真	021-20963885
互联网网址	www.ic-seal.com
电子信箱	IR@ic-seal.com
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
主营业务	公司主要从事半导体级全氟醚橡胶材料及密封件的研发、设计、制造和销售，主要产品包括全氟醚橡胶密封圈、全氟醚橡胶功能部件等
本次证券发行的类型	首次公开发行股票并在科创板上市

（二）发行人的主营业务、核心技术、研发水平

1、发行人主营业务

公司是国内半导体级全氟醚橡胶密封件领军企业，深度聚焦全氟醚橡胶的技术研发和应用创新，在国内率先实现自主开发半导体级全氟醚橡胶材料并稳定量产全氟醚橡胶密封圈等半导体设备关键零部件，有效打破了美国杜邦、美国 GT、英国 PPE 等外资企业在我国半导体级全氟醚橡胶密封圈领域的垄断局面。公司基于自研配方生产的全氟醚橡胶材料，为国内半导体设备厂商和晶圆厂商的刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗等前道制程核心工艺设备提供全系列点位真空密封所用的全氟醚橡胶密封圈、全氟醚橡胶功能部件等产品。公司产品能有效胜任半导体前道制程核心工艺设备不同型号和全系列点位的严苛真空密封要求，可全面覆盖先进制程和成熟制程技术节点并在 232 层 NAND 存储芯片、19nm 及以下 DRAM 存储芯片和 5nm-14nm 逻辑芯片等先进制程实现突破和规模化销售，通过充分满

足半导体设备的多样化和定制化需求，服务于技术和制程不断迭代的半导体设备。根据弗若斯特沙利文统计，2023 年、2024 年公司半导体级全氟醚橡胶密封圈销售规模连续两年在中国市场排名第三，在中国企业中排名第一，公司已成长为国内半导体设备用高端全氟醚橡胶密封圈的头部企业。

半导体前道工艺主要完成晶圆制造，该等工艺设备类型复杂、技术难度较高，对工艺环境和零部件的要求极为严苛。公司全氟醚橡胶密封圈是构成半导体前道工艺设备真空环境所必备的“耗材类”关键零部件，其中部分核心产品系构筑反应腔体真空环境，与晶圆加工反应区直接接触，长期处于超高温、强腐蚀、富等离子体、强酸碱等恶劣腔体反应环境中，其性能直接影响晶圆制造良率和晶圆连续生产时间，是半导体前道工艺设备的关键零部件；同时由于全氟醚橡胶密封圈在常规使用过程中会出现正常损耗，因此需定期更换以保障其性能，根据弗若斯特沙利文统计数据，全氟醚橡胶密封圈为晶圆制造中消耗价值量占比第二大的“耗材类”关键零部件。

公司是国家级专精特新“小巨人”企业，自成立以来始终专注于半导体级全氟醚橡胶材料及密封件的研发创新和产业化应用，根据中国石油和化学工业联合会 2025 年科技成果鉴定，公司“电子产业用全氟醚橡胶密封件制备技术”总体达到国内领先水平，关键指标达到国际先进水平。同时，公司积极参与国家重大项目研发，承担了科技部“14 纳米集成电路生产装备所需关键零部件自主可控研发”项目子课题。根据中国集成电路零部件创新联盟 2024 年出具的证明，“全氟醚橡胶密封圈属于设备关键零部件，公司自主研发的全氟醚橡胶密封圈已在集成电路领域实现批量应用，市场占有率位居全国前列，对于保障我国集成电路产业供应链的安全可控和集成电路产业的稳定发展具有重要作用”。

2、发行人核心技术情况

公司核心技术均系自主研发形成，通过反复科学实验和技术攻关，公司先后成功开发出耐等离子体、超洁净、耐高温、耐酸碱四大系列全氟醚橡胶材料配方和生产工艺，构建起复配配方技术、生产工艺技术、产品应用技术等三大核心技术有机融合的一体化技术研发体系和数据库平台。发行人的核心技术系基于持续的研发投入及技术积累并在研发团队共同努力下逐步形成。

（1）复配配方技术

全氟醚橡胶复配配方技术是指对全氟醚生胶、硫化剂、功能填料等各组材料进行种类选择并确定含量和配比等配方参数，是公司产品的关键技术，直接影响全氟醚橡胶制品的理化指标与应用性能。全氟醚橡胶由全氟醚生胶通过硫化剂的硫化、功能填料的复配混炼等配合改性制成，其技术性能较大程度上取决于配方的组分、含量、配比等参数设计。复配配方设计需综合考虑不同组分材料的功能特性，并基于大量实验数据和应用经验确定或调整配方的组分、含量和配比等，从而显著提高全氟醚橡胶密封圈的关键性能，包括物理机械性能以及耐高温、耐介质、耐等离子体和超洁净等诸多维度综合性能，以满足下游特定用途、功能和工艺要求。

其中，公司针对全氟醚生胶进行深入的基础研究并构建了较为完善的生胶数据库，全面研究数十种全氟醚生胶的聚合单体化学结构，深度剖析单体的组成和结构对聚合物链结构、分子量分布的影响机制及与全氟醚橡胶物理机械性能、热稳定性、加工性能的关联性，从而可根据不同应用场景需求精准快速筛选出最为合适的全氟醚生胶；公司针对硫化剂建立了强大的硫化剂数据应用体系，在熟练掌握市场通用硫化剂的基础上，自主开发拓展了数百种硫化剂、促进剂，通过有效提高全氟醚橡胶分子的交联密度和反应效果，进一步增强产品性能、提升产品寿命；公司针对功能填料建立了完善的填料数据体系，深入研究并掌握数百种有机填料和无机填料的分子特性和使用技术，并运用偶联剂接枝、等离子体处理等先进表面处理技术，促使功能填料在聚合物基体中均匀分散，进而大幅提升复合材料的加工性能和物理机械性能、耐高温、耐介质等性能的长期稳定性。公司复配配方技术是自主研发创新与行业经验积累的集成与整合，是公司多年深耕行业而形成的竞争优势，不属于行业通用技术，竞争对手难以在短期内复制。

（2）生产工艺技术

生产工艺技术是全氟醚橡胶密封圈生产过程的关键，也是核心技术转化为最终产品的实现手段，公司全氟醚橡胶密封圈生产工艺的关键流程包括混炼、挤出、一次硫化、二次硫化等，每个关键工艺环节都会影响产品的性能和质量。公司生产工艺技术包括经过反复科学实验和研究摸索形成的放大工艺技术以及生产实践所掌握的投料顺序、挤出速度、时间控制、温度控制、压力控制等独特生产技

术诀窍（Know-How），有效保证了公司全氟醚橡胶密封圈多维度综合性能的实现和产品质量的一致性、稳定性和可靠性。

（3）产品应用技术

产品应用技术是对全氟醚橡胶密封圈的应用工艺、使用效果、技术性能等进行实验分析、数据理解并根据下游性能需求调整复配配方、生产工艺的能力，是构成公司整体解决方案的重要技术。公司产品下游应用需求严苛，刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗等各类型半导体前道工艺设备对零部件的功能有不同苛刻要求，为使全氟醚橡胶密封圈性能指标达到最佳状态，公司不仅拥有复配配方研发技术和生产工艺技术，还构建起了完善的应用技术架构体系，即公司能将下游客户的性能使用要求量化匹配为影响复配配方或工艺参数设计的定量因素并针对性地反向调整复配配方或工艺参数。

公司依托先进的应用技术不仅能精准研发制造出匹配各应用点位严苛性能要求的密封产品，还有效解决了产品实际使用过程中出现的各类问题；同时，公司结合历史应用经验和日常售前售后服务积累的丰富应用信息数据，为客户各应用点位快速精准匹配合适性能的密封产品，以有效解决不同工艺设备和不同应用点位的产品适配性问题，从而为客户提供综合性能最优的密封解决方案。

3、发行人研发水平

报告期内，公司研发费用分别为 700.61 万元、1,477.89 万元和 2,234.30 万元，分别占营业收入的 16.85%、11.33%和 10.76%。自成立至今，公司已量产 10 余款全氟醚橡胶材料，在研 10 余款全氟醚橡胶新材料，已累计设计开发并量产 2,000 余款全氟醚橡胶密封圈。公司产品能有效胜任半导体前道制程核心工艺设备不同型号和全系列点位的严苛真空密封要求，可全面覆盖先进制程和成熟制程技术节点并在 232 层 NAND 存储芯片、19nm 及以下 DRAM 存储芯片和 5nm-14nm 逻辑芯片等先进制程实现突破和规模化销售。

公司全氟醚橡胶密封圈具有优异的物理机械性能以及耐高温、耐介质、耐等离子体和超洁净等突出性能，配方研发难度大、工艺技术复杂，需要经过半导体设备厂商和晶圆厂商的严苛验证，根据中国石油和化学工业联合会 2025 年科技成果鉴定，公司“电子产业用全氟醚橡胶密封件制备技术”总体达到国内领先水

平，关键指标达到国际先进水平。同时，公司积极参与国家重大项目研发，承担了科技部“14 纳米集成电路生产装备所需关键零部件自主可控研发”项目子课题，有效助力我国半导体关键零部件产业的技术突破和升级迭代。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

根据天健会计师出具的《审计报告》（天健审〔2025〕6-361 号），公司报告期主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项目	2024.12.31 /2024 年度	2023.12.31 /2023 年度	2022.12.31 /2022 年度
资产总额	47,551.36	33,392.36	25,096.15
归属于母公司所有者权益	41,760.70	27,980.51	21,086.51
资产负债率（母公司）	11.94%	16.21%	15.98%
营业收入	20,755.23	13,047.49	4,159.03
净利润	6,893.56	3,638.84	173.38
归属于母公司所有者的净利润	6,893.56	3,638.84	173.38
扣除非经常损益后 归属于母公司所有者的净利润	6,308.94	3,281.15	-112.15
基本每股收益（元/股）	1.33	-	-
稀释每股收益（元/股）	1.33	-	-
加权平均净资产收益率	19.47%	14.83%	0.84%
经营活动产生的现金流量净额	4,818.43	2,858.35	-604.75
现金分红	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	10.76%	11.33%	16.85%

注：公司 2022 年度、2023 年度为有限公司，故相应财务报表期间内不适用每股收益的计算。

上述财务指标计算公式如下：

- （1）资产负债率=负债总额÷资产总额
- （2）研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
- （3）基本每股收益=P0÷S；S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
- （4）稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
- 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀

释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

（四）发行人存在的主要风险

1、客户集中度相对较高的风险

报告期内，公司前五大客户（同一控制下合并计算）的销售收入占同期主营业务收入的比例分别为 79.18%、78.82%和 77.06%，客户集中度相对较高。公司核心产品全氟醚橡胶密封圈主要应用于半导体前道制程核心工艺设备中，是半导体设备“耗材类”关键零部件，下游半导体设备厂商和晶圆厂商系技术和资本高度密集的产业，呈现数量少、规模大的特征，下游行业集中度较高致使公司客户集中度亦相对较高。若未来公司主要客户发展战略发生重大变化，或由于经营不善、产业政策调整、行业竞争加剧、行业景气度变化以及突发事件等原因导致业绩下滑，进而减少对公司产品的采购金额，而公司未能及时有效开拓新客户资源并转化为收入，则将可能对公司经营业绩产生不利影响。

2、供应商集中度较高及原材料供应风险

全氟醚生胶是公司生产所需的主要原材料，全氟醚生胶生产合成技术复杂，目前全球仅少数企业具备合成能力，美国、日本、欧洲等地区在全氟醚生胶领域的技术发展起步较早，技术积累较为深厚，相关产业成熟度较高。近年来，国内亦有部分公司实现了全氟醚生胶合成的突破，但总体技术水平和产能规模与国外领先公司相比尚有较大差距。报告期内，公司全氟醚生胶采购主要通过进口取得，公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例分别为 88.00%、94.38%和 90.62%，因上游原材料行业集中度较高致使公司供应商集中度亦相应较高。虽然公司已与主要全氟醚生胶供应商签署了长期供货的战略合作协议，但如果未来公司与主要供应商合作关系发生变化，或相关供应商自身经营状况、交付能力发生重大不利变化，再或由于国际贸易摩擦、公司主要原材料价格受市场影响出现上升，将可能对公司原材料供应的稳定性、及时性和采购价格产生不利影响，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

3、毛利率波动或下滑的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 41.57%、54.82%、62.16%，逐年有所上升，其变动主要受产能利用率提升、上游原材料采购价格下降、产品结构及

型号变化等因素共同影响。如果未来公司主要原材料全氟醚生胶采购价格发生较大波动,或者未来宏观经济政策发生重大不利变动、半导体产业景气度不及预期、市场竞争加剧等因素致使公司与客户议价能力减弱、生产及供货能力受阻,以及出现公司未能有效开发新配方、产品淘汰过时等不利情形时,将可能导致公司主营业务毛利率出现波动甚至下降的风险。

4、产品研发升级风险

公司主要从事半导体级全氟醚橡胶材料及密封件的研发、设计、制造和销售,公司产品凭借优异的物理机械性能以及耐高温、耐介质、耐等离子体、超洁净等多维度综合性能,能有效胜任半导体前道制程核心工艺设备不同型号和全系列点位的严苛真空密封要求,可全面覆盖先进制程和成熟制程技术节点并在 232 层 NAND 存储芯片、19nm 及以下 DRAM 存储芯片和 5nm-14nm 逻辑芯片等先进制程实现突破和规模化销售。随着半导体制造工艺的日益先进及设备构造的日益复杂精细,下游客户对全氟醚橡胶密封圈的性能要求也更加苛刻,这对公司的产品研发和技术创新能力提出了更高要求,公司须紧跟下游客户需求变动不断提高技术研发水平并升级迭代产品性能,以持续保持技术和产品的竞争优势。未来若公司无法持续提升研发能力、无法根据终端市场需求不断升级现有产品并开发新产品系列,则可能使公司在日益激烈的市场竞争环境中处于劣势地位,从而对公司市场份额和核心竞争力产生不利影响。

二、本次发行概况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股 (A 股)		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 1,727.5588 万股	占发行后总股本的比例	不低于 25%
其中: 发行新股数量	不超过 1,727.5588 万股	占发行后总股本的比例	不低于 25%
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本的比例	不适用
发行后总股本	不超过 6,910.2353 万股		
每股发行价格	【】 元/股		
发行市盈率	【】 倍 (按发行价格除以发行后每股收益计算)		
发行前每股净资产	【】 元	发行前每股收益	【】 元
发行后每股净资产	【】 元	发行后每股收益	【】 元

发行市净率	【】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	本次发行将采用网下向询价对象配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或者中国证监会认可的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设证券账户并已开通科创板市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
募集资金总额	【】万元
募集资金净额	【】万元
募集资金投资项目	半导体级全氟醚橡胶密封件研发及产业化建设项目 研发中心建设项目
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元。其中：承销及保荐费【】万元；审计及验资费【】万元；律师费【】万元；其他【】万元
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售认购本次公开发行新股的，公司将依据相关法律法规的要求，适时履行相应审议程序及其他相关所需程序，并依法详细披露
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐人将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上海证券交易所相关规定执行。保荐人及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海证券交易所提交相关文件
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	不适用
（二）本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式

（一）本次证券发行上市的保荐代表人

本保荐机构指定俞乐、胡琳扬担任上海芯密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的保荐代表人，其相关信息如下：

姓名	保荐业务执业情况
俞乐	国金证券投资银行部董事总经理、保荐代表人，具有 10 余年投资银行从业经验。曾主持永臻股份（603381.SH，2024）IPO、盘古智能（301456.SZ，2023）

	IPO、珠城科技（301280.SZ，2022）IPO、冠中生态（300948.SZ，2021）IPO、松原股份（300893.SZ，2020）IPO、祥生医疗（688358.SH，2019）IPO、电魂网络（603258.SH，2016）IPO 等项目；曾主持或参与冠中生态（300948.SZ，2023）可转债发行、回天新材（300041.SZ，2022）可转债发行、回天新材（300041.SZ，2020）非公开发行股份、天地科技（600582.SH，2016）公开发行公司债券、七匹狼（002029.SZ，2012）非公开发行股份、抚州城投债等项目；曾主持或参与天地科技（600582.SH，2014）重大资产重组项目、中国天楹（000035.SZ，2014）借壳上市重大资产重组项目、宝鹰股份（002047.SZ，2013）借壳上市重大资产重组项目、四川双马（000935.SZ，2011）与拉法基中国的重大资产重组项目；曾主持艾录股份（830970.OC，2014）新三板挂牌及做市等多个项目，在 IPO、再融资、并购重组及新三板业务领域具有极为丰富的项目运作经验
胡琳扬	国金证券投资银行部董事总经理、保荐代表人，具有 10 余年投资银行从业经验。曾主持或参与松原股份（300893.SZ，2020）IPO、祥生医疗（688358.SH，2019）IPO 等项目；曾主持或参与回天新材（300041.SZ，2022）可转债发行、回天新材（300041.SZ，2020）非公开发行股份、中国天楹（000035.SZ，2016）非公开发行股份、天地科技（600582.SH，2016）公开发行公司债券等项目；曾主持或参与中国天楹（000035.SZ，2018）重大资产重组项目、中国天楹（000035.SZ，2015）重大资产购买项目、中国天楹（000035.SZ，2014）借壳 ST 科健重大资产重组项目、天地科技（600582.SH，2014）借壳上市重大资产重组项目；曾主持或参与天地华泰（834256，2015）新三板分拆挂牌、艾录股份（830970，2014）新三板挂牌及 6 次非公开发行股份（含资产收购）等项目，在 IPO、再融资、并购重组和新三板业务领域等具有极为丰富的项目运作经验

（二）本次证券发行项目协办人

本保荐机构指定单良为本次发行的项目协办人，其执业情况如下：

单良先生，国金证券投资银行部资深业务经理，曾主持或参与珠城科技（301280.SZ，2022）IPO、松原股份（300893.SZ，2020）IPO、祥生医疗（688358.SH，2019）IPO 以及多家公司的 IPO 辅导及重大资产重组项目，具有丰富的 IPO、再融资、并购重组和新三板挂牌等各项资本运作经验。

（三）本次证券发行项目组其他成员

本次发行项目组其他成员：朱可、陈诚、吴立慧。

（四）联系地址、电话和其他通讯方式

保荐人（主承销商）	国金证券股份有限公司
联系地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
邮编	200120
联系电话	021-68826801
传真	021-68826800

四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

（一）本保荐机构另类投资子公司国金创新投资有限公司拟通过参与本次发行战略配售持有发行人股份，具体的认购比例以国金创新投资有限公司与发行人签订的战略配售协议为准。除上述情况外，截至本上市保荐书签署日，本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）截至本上市保荐书签署日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份导致影响公正履行保荐职责的情况。

（三）截至本上市保荐书签署日，本保荐机构的保荐代表人及其配偶，本保荐机构的董事、监事、高级管理人员均不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）截至本上市保荐书签署日，本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情形。

（五）截至本上市保荐书签署日，本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项

保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，国金证券作出如下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施、自愿接受上海证券交易所的自律监管。

（九）中国证监会、上交所规定的其他事项。

国金证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、上交所对推荐证券上市的规定，自愿接受上交所的自律监管。

六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明

（一）董事会的批准

2025年3月21日，发行人召开第一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等关于发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

（二）股东大会的批准

2025年4月7日，发行人召开2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了发行人董事会提交审议的《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等关于发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

经核查，本保荐机构认为，发行人已就本次首次公开发行股票并在科创板上

市履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定以及上交所的有关业务规则的决策程序。

七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程

（一）发行人符合科创板支持方向

1、公司主营产品属于半导体设备“耗材类”关键零部件，符合国家战略和新质生产力发展方向

半导体行业是我国科技创新和战略新兴产业发展的重点支持领域，国务院、发改委及工信部等先后颁布一系列鼓励和推动半导体行业发展的规划纲要和产业政策，为产业发展提供了强有力的政策支持和良好政策环境。公司核心产品全氟醚橡胶密封圈作为半导体设备“耗材类”关键零部件，充分受益于半导体行业的持续利好政策环境，迎来良好的发展契机，如工信部、财政部发布的《关于印发电子信息制造业 2023—2024 年稳增长行动方案的通知》（2023 年版）提出“优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平，增强材料、设备及零配件等配套能力。”此外，公司自研配方生产的全氟醚橡胶材料作为氟橡胶中的高端产品，亦被工信部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录》（2024 年版）列入目录先进基础材料，有助于加快推进行业产业化和规模化应用，开拓全氟醚橡胶材料的应用前景。

半导体级全氟醚橡胶密封圈是半导体晶圆制造过程中消耗价值量占比第二大的“耗材类”关键零部件，需在超高温、强腐蚀、富等离子体、强酸碱等恶劣腔体环境中，保持良好的真空密封性和极低的质量损失率。全氟醚橡胶密封圈性能的稳定直接影响晶圆制造设备连续生产的时间和可靠性，需定期更换以保障其性能，若设备腔体内的全氟醚橡胶密封圈因腐蚀或高温老化等原因而变形失效，腔体内的真空环境将无法得到保障，从而会导致设备停机、产线停产，甚至会有晶圆批量报废的风险，损失代价极大。因此，全氟醚橡胶密封圈是维持半导体设备运行效率和晶圆制造良率的重要保障。

2、公司核心技术具有先进性，产品关键技术达到国际先进水平

公司是国家级专精特新“小巨人”企业，自成立以来始终专注于半导体级全

氟醚橡胶材料及密封件的研发创新和产业化应用,通过反复的科学实验和生产实践,成功攻克并掌握关键的复配配方技术、生产工艺技术和产品应用技术,拥有涵盖全氟醚橡胶材料配方研发、产品精密加工和应用服务等在内的全套技术和服务体系,建立了一体化的技术研发综合平台和数据库系统。公司具备先进的技术研发水平和创新能力,能够根据不同下游应用工况需求快速精准开发匹配性能的材质和产品,并依托领先的产品应用技术和经验协助客户实现全氟醚橡胶密封圈的精准应用和定制化开发。

公司全氟醚橡胶密封圈具有优异的物理机械性能以及耐高温、耐介质、耐等离子体和超洁净等突出性能,配方研发难度大、工艺技术复杂,需要经过半导体设备厂商和晶圆厂商的严苛验证,根据中国石油和化学工业联合会 2025 年科技成果鉴定,公司“电子产业用全氟醚橡胶密封件制备技术”总体达到国内领先水平,关键指标达到国际先进水平。同时,公司积极参与国家重大项目研发,承担了科技部“14 纳米集成电路生产装备所需关键零部件自主可控研发”项目子课题,有效助力我国半导体关键零部件产业的技术突破和升级迭代。

3、公司产品已获国内主流知名半导体厂商认证,应用于先进制程并实现规模化销售

由于半导体前道设备制程越先进,其工艺环境越恶劣,对全氟醚橡胶密封圈的性能要求越高,公司凭借领先的技术优势,通过持续研发和产品升级,已具备向先进制程半导体设备批量稳定供应产品的能力,能有效满足工艺制程日益提高时的严苛产品应用需求。依托过硬的技术实力和科技创新能力,公司能够应用先进技术不断对产品性能进行迭代升级并将先进技术转化为新一代产品。自成立至今,公司已量产 10 余款全氟醚橡胶材料,在研 10 余款全氟醚橡胶新材料,已累计设计开发并量产 2,000 余款全氟醚橡胶密封圈。公司产品能有效胜任半导体前道制程核心工艺设备不同型号和全系列点位的严苛真空密封要求,可全面覆盖先进制程和成熟制程技术节点并在 232 层 NAND 存储芯片、19nm 及以下 DRAM 存储芯片和 5nm-14nm 逻辑芯片等先进制程实现突破和规模化销售。

随着公司产品成功实现技术突破、达到国际先进技术水平并可与美国杜邦、美国 GT、英国 PPE 等外资企业直接竞争,公司自 2021 年起已先后成功通过国内主流知名半导体厂商的严苛产品认证并实现批量稳定供应,包括中国大陆前十

大晶圆制造厂商中的九家公司，中国大陆前五大半导体设备厂商中的四家公司，公司已成长为国内半导体设备用高端全氟醚橡胶密封圈的头部企业。

4、公司行业地位突出，产品成功实现国产替代，在国内市场排名内资企业第一

半导体级全氟醚橡胶密封圈领域技术门槛高、国产化率低，长期以来其国内市场被欧美日等外资企业所垄断。根据弗若斯特沙利文统计，半导体级全氟醚橡胶密封圈 2024 年的国产化率不足 10%，国产替代潜力巨大。公司是国内半导体级全氟醚橡胶密封件领军企业，深度聚焦全氟醚橡胶的技术研发和应用创新，在国内率先实现自主开发半导体级全氟醚橡胶材料并稳定量产全氟醚橡胶密封圈等半导体设备关键零部件，有效打破了外资企业在我国半导体级全氟醚橡胶密封圈领域的垄断局面。凭借过硬的技术实力和优异的产品性能，公司产品在半导体晶圆制造的前道设备领域实现深度融合和广泛应用，逐步占领外资企业在国内的市场份额，成功实现国产替代。根据中国集成电路零部件创新联盟 2024 年出具的证明，公司自主研发的全氟醚橡胶密封圈已在集成电路领域实现批量应用，市场占有率位居全国前列。根据弗若斯特沙利文统计，2023 年、2024 年公司半导体级全氟醚橡胶密封圈销售规模连续两年在中国市场排名第三，在中国企业中排名第一，公司已成长为国内半导体设备用高端全氟醚橡胶密封圈的领先企业。

(二) 发行人符合科创板行业领域的规定

公司所属行业领域	☒ 新一代信息技术	公司主要产品为半导体级全氟醚橡胶密封件，是构成半导体前道工艺设备真空环境的必备零部件，属于半导体设备关键零部件。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“C3985 电子专用材料制造”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2.3 高储能和关键电子材料制造”；根据工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》，公司自研配方生产的全氟醚橡胶材料属于“三、先进化工材料”之“（一）特种橡胶及其他高分子材料”之“78 氟橡胶”之“（1）全氟醚橡胶”
	☐ 高端装备	
	☐ 新材料	
	☐ 新能源	
	☐ 节能环保	
	☐ 生物医药	
	☐ 符合科创板定位的其他领域	

综上所述，公司所属行业符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条（一）中所规定的“新一代信息技术领域”之“半导体和集成电路”行业领域的要求。

（三）发行人符合科创属性相关指标要求

公司同时符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》
第六条科创属性规定的 4 项指标，符合科创板定位，具体指标情况如下：

科创属性评价标准一	是否符合	发行人指标情况
最近三年研发投入占营业收入比例≥5%，或最近三年研发投入金额累计≥8,000 万元	☒ 是 ☐ 否	公司最近三年累计研发投入为 4,412.79 万元，最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为 11.62%，超过 5%
研发人员占当年员工总数的比例≥10%	☒ 是 ☐ 否	截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有 175 名员工，研发人员 24 名，研发人员占员工总数的比例为 13.71%，超过 10%
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利≥7 项	☒ 是 ☐ 否	截至 2025 年 4 月 30 日，公司拥有应用于主营业务并能够产业化的已获授权发明专利 22 项，超过 7 项
最近三年营业收入复合增长率≥25%，或最近一年营业收入金额≥3 亿元	☒ 是 ☐ 否	2022 年-2024 年，公司营业收入分别为 4,159.03 万元、13,047.49 万元、20,755.23 万元，年复合增长率达 123.39%，超过 25%

（四）发行人符合国家产业政策

公司核心产品半导体级全氟醚橡胶密封圈是半导体前道工艺设备的“耗材类”关键零部件。根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司主营业务属于国家“鼓励类”产业。全氟醚橡胶密封圈的发展与半导体产业密切相关，半导体行业是我国科技创新和战略新兴产业发展的重点支持领域，国务院、发改委及工信部等先后颁布一系列鼓励和推动半导体行业发展的规划纲要和产业政策，包括《国家集成电路产业发展推进纲要》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《关于印发电子信息制造业 2023—2024 年稳增长行动方案的通知》等，着力优化半导体产业布局并提升高端供给水平，增强材料、设备及零配件等配套能力，为半导体行业发展提供有力的制度保证和政策支持。公司主要产品和业务对于提高我国半导体设备关键零部件的自主可控能力具有重大战略意义，充分保障了国产设备原装零部件和晶圆厂耗材替换的稳定供应和产业链安全，符合国家科技创新战略及相关产业政策要求。

（五）保荐机构执行核查程序

针对发行人符合科创板定位要求及国家产业政策的情况，保荐机构执行了以下核查程序：

- 1、查阅国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《战略

性新兴产业分类（2018）》，对发行人所处行业进行分析；

2、访谈发行人管理层，了解公司主营业务及主要产品、业务模式、市场竞争格局、公司市场地位等情况；

3、对发行人研发人员和生产人员进行了访谈，实地参观公司车间，了解公司研发模式、核心技术、研发项目、生产模式、生产工艺等情况；

4、查阅半导体及全氟醚橡胶行业咨询和研究报告，了解晶圆制造、半导体设备和零部件、全氟醚橡胶材料和密封件产业链的发展趋势、竞争格局等情况；

5、获取处于半导体类似产业链位置的 A 股上市公司公开披露信息，对发行人所处行业的发展趋势、竞争格局及自身优势进行更全面的对比分析；

6、对主要客户、供应商进行了走访，了解公司在所属行业的市场地位。

八、保荐人关于发行人是否符合《科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明

（一）符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条之“（一）符合中国证监会规定的发行条件”规定

保荐人对发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市是否符合《首发管理办法》规定的发行条件进行了逐项核查，核查结果如下：

1、发行人符合《首发管理办法》第十条的规定

本保荐机构查阅了发行人的工商档案，发行人系由有限公司整体变更设立，为依法设立且合法存续的股份有限公司。发行人前身为上海芯密科技有限公司，于 2020 年 1 月 21 日成立，并于 2024 年 10 月 28 日按经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。截至本上市保荐书出具日，发行人持续经营时间超过三年，公司具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首发管理办法》第十条的规定。

2、发行人符合《首发管理办法》第十一条的规定

根据发行人的相关财务管理制度、申报会计师出具的标准无保留意见《审计报告》（天健审〔2025〕6-361 号）并经本保荐机构核查，发行人的会计基础工作

规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由申报会计师出具了标准无保留意见的《审计报告》。

根据发行人的内部控制制度、申报会计师出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2025〕6-362号）并经本保荐机构核查，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由申报会计师出具了标准无保留结论的《内部控制审计报告》。

综上，发行人符合《首发管理办法》第十一条的规定。

3、发行人符合《首发管理办法》第十二条的规定

根据发行人工商档案、发行人控股股东、实际控制人《调查表》、主要资产权属证明文件，并访谈发行人高级管理人员，经本保荐机构核查，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响发行人独立性或者显失公平的关联交易。

发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近二年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化。发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近二年实际控制人没有发生变更。

公司不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

综上，发行人符合《首发管理办法》第十二条的规定。

4、发行人符合《首发管理办法》第十三条的规定

发行人的主营业务为半导体级全氟醚橡胶材料及密封件的研发、设计、制造和销售，发行人的生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

根据上海市公共信用信息服务中心出具的市场主体《专用信用报告》，发行人控股股东、实际控制人的《无犯罪记录证明》及其填写的《调查表》，并经网

络核查，最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

发行人董事、监事/审计委员会成员、高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。

综上，发行人符合《首发管理办法》第十三条的规定。

综上所述，经核查，本保荐机构认为发行人符合《首发管理办法》规定的发行条件。

（二）发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定

发行人发行前的股数为 5,182.6765 万股，本次拟公开发行新股数量不超过 1,727.5588 万股，发行人本次发行后的股本总额不低于人民币 3,000 万元，符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（二）项的规定。

（三）发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”规定

本次公开发行前发行人总股本为 5,182.6765 万股，本次拟发行人民币普通股不超过 1,727.5588 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%（最终发行数量以中国证监会注册为准），符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（三）项的规定。

（四）发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条之“（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准”规定

根据申报会计师出具的《审计报告》（天健审（2025）6-361 号），发行人 2023 年、2024 年实现营业收入分别为 13,047.49 万元、20,755.23 万元，归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 3,281.15 万元、6,308.94

万元；结合发行人最近一次增资的估值情况，预计发行人发行后总市值不低于10亿元。发行人符合《科创板上市规则》第2.1.1条第一款第（四）项的规定。

（五）发行人符合《科创板上市规则》第2.1.1条之“（五）上海证券交易所规定的其他上市条件”规定

经核查，发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

综上所述，本保荐机构认为：发行人本次发行上市符合《科创板上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的上市条件。

九、持续督导期间的工作安排

发行人拟申请首发公开发行股票并在科创板上市，持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度。持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，保荐机构将就尚未完结的保荐工作继续履行持续督导职责。本保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排如下：

持续督导事项	持续督导工作计划及安排
督促上市公司建立和执行信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度	1、协助和督促发行人建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，确保发行人及其控股股东、实际控制人、董事、审计委员会成员、高级管理人员、核心技术人员知晓其在《科创板上市规则》下的各项义务； 2、持续督促发行人充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；对发行人制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂； 3、督促发行人及其控股股东、实际控制人、董事、审计委员会成员、高级管理人员、核心技术人员对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露；针对承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺；发行人及其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合《科创板上市规则》以及上海证券交易所其他规定的，及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正； 4、督促发行人积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度； 5、关注发行人使用募集资金的情况，督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况。
识别并督促上市公司披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事	持续关注发行人运作情况，对发行人及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注发行人日常经营和股票交易情况，有效识别并督促发行人披露重大风险或者重大负面事项，并就信息披露是否真实、准确、完整及其他内容发表意见。

持续督导事项	持续督导工作计划及安排
项，并发表意见	
关注上市公司股票交易异常波动情况，督促上市公司按照本规则规定履行核查、信息披露等义务	1、持续关注上市公司的股票交易情况，当上市公司股票发生异常波动时，督促上市公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定及时进行检查，履行相应信息披露义务； 2、督促控股股东、实际控制人、董事、审计委员会成员、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。
对上市公司存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告	关注并审阅发行人的定期和临时报告；关注新闻媒体涉及发行人的报道，对可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查： 1、上市公司出现下列情形之一的，自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查： （1）存在重大财务造假嫌疑；（2）控股股东、实际控制人、董事、审计委员会成员、高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（3）可能存在重大违规担保；（4）资金往来或者现金流存在重大异常；（5）交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项； 2、就核查情况、提请上市公司及投资者关注的问题、本次现场核查结论等事项出具现场核查报告，并在现场核查结束后 15 个交易日内披露。
定期出具并披露持续督导跟踪报告	定期跟踪了解公司情况，通过列席发行人董事会、股东会等方式对发行人运营情况进行了解： 1、在上市公司年度报告、半年度报告披露之日起 15 个交易日内，披露持续督导跟踪报告； 2、上市公司未实现盈利、业绩由盈转亏、营业收入与上年同期相比下降 50%以上或者其他主要财务指标异常的，在持续督导跟踪报告显著位置就上市公司是否存在重大风险发表结论性意见。

十、保荐人关于本项目的推荐结论

本次发行申请符合法律法规和中国证监会及上交所的相关规定。保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐人认为：本次芯密科技发行上市符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及上交所有关规定；国金证券同意作为芯密科技本次首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，并承担保荐人的相应责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海芯密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签署页）

项目协办人： 单良 2025年6月13日
单良

保荐代表人： 俞乐 2025年6月13日
俞乐

胡琳扬 2025年6月13日
胡琳扬

内核负责人： 郑榕萍 2025年6月13日
郑榕萍

保荐业务负责人： 廖卫平 2025年6月13日
廖卫平

保荐机构董事长：
（法定代表人） 冉云 2025年6月13日
冉云

保荐机构（公章）： 国金证券股份有限公司 2025年6月13日

